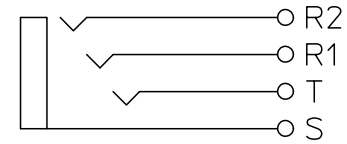
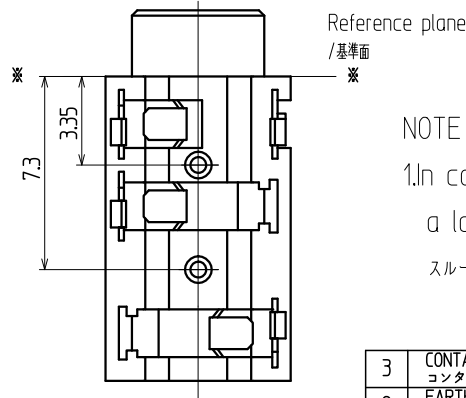
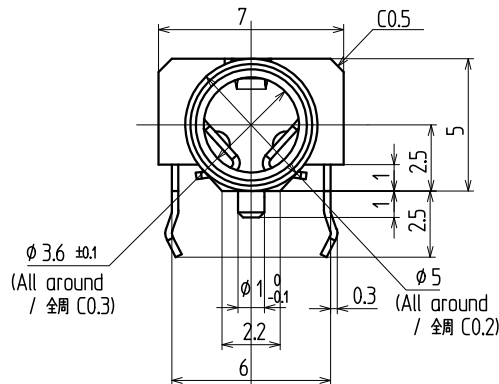
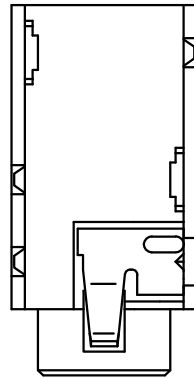
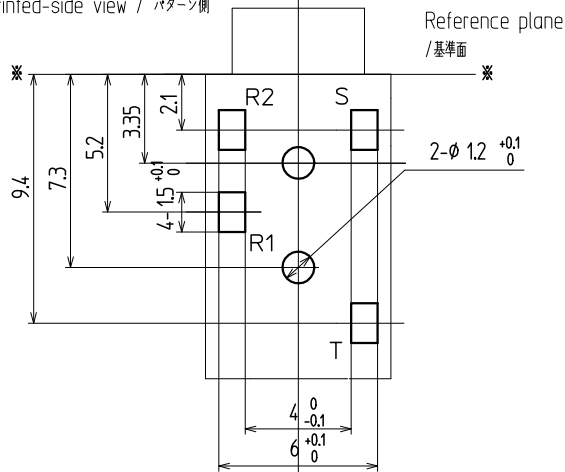


Note / 注1

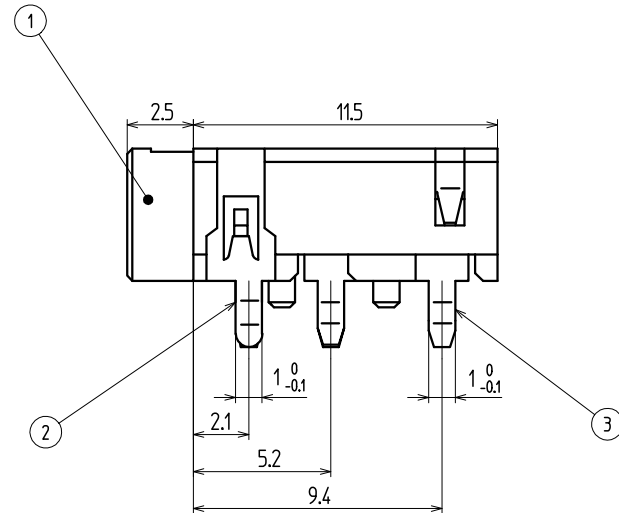
Dimensions of PC board holes / 参考基板孔

Tolerance / 公差 all±0.1 t1.2

Printed-side view / パターン側



Circuit / 回路図



NOTE / 注記

1.In case use P.C board of through holes, don't prepare a land in part side.

スルーホール基板を使用する際は、部品面側にランドを設けない事。

3.5 DIA LA4 t1.2

3	CONTACT コンタクト	3	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	t0.25	(T,R1,R2)		SILVER PLATED Agめっき	
2	EARTH CONTACT アースパネ	1	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	t0.25	(S)		SILVER PLATED Agめっき	
1	HOUSING ハウジング	1	PA66 G15%	BLACK 黒		94V-0		
No. 品番	PARTS NAME 名称	QTY 個数	MATERIAL 材質		No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考

ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY
()印は、参考寸法

APPROVED 責任者	CHECKED 検査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者
-----------------	----------------	--------------	-----------------

(A) 永	P 製	TITLE 名称	3.5 DIA PHONE JACK / 小形単頭ジャック	ISSUED 出図
(C) 図	□	CODE No. コードNo.	YKB21-5263B	
UNIT 単位	mm	DRAWING No. 図番		
SCALE 尺度	5/1	PAGE ページ		REVISION 原取
		CUSTOMER CODE ユーザーコード		

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.

TOLERANCE 寸法公差		X
6 under 未満	± 0.3	X
over 6 以上	20 ± 0.4	X
over 20 以上	± 0.5	X
over 以上	±	X
ANGLE(DEG) 角 度	± 0°	MARK 記号

REVISIONS
改訂事項

DATE
日付

SIGN
担当